

2025年11月14日
日本ガイシ株式会社

ハイセラムキャリアの生産能力を約3倍に増強

～次世代半導体市場への対応強化～

日本ガイシ株式会社(社長:小林茂、本社:名古屋市)は、AIや自動運転などの先端分野で注目されるチップレット集積に対応するため、「ハイセラムキャリア」の生産能力を2027年度までに現在の約3倍に増強します。これにより、NGKグループ全体で安定した供給体制を確立することで、高性能半導体市場において2030年度に売上高200億円の達成を目指します。

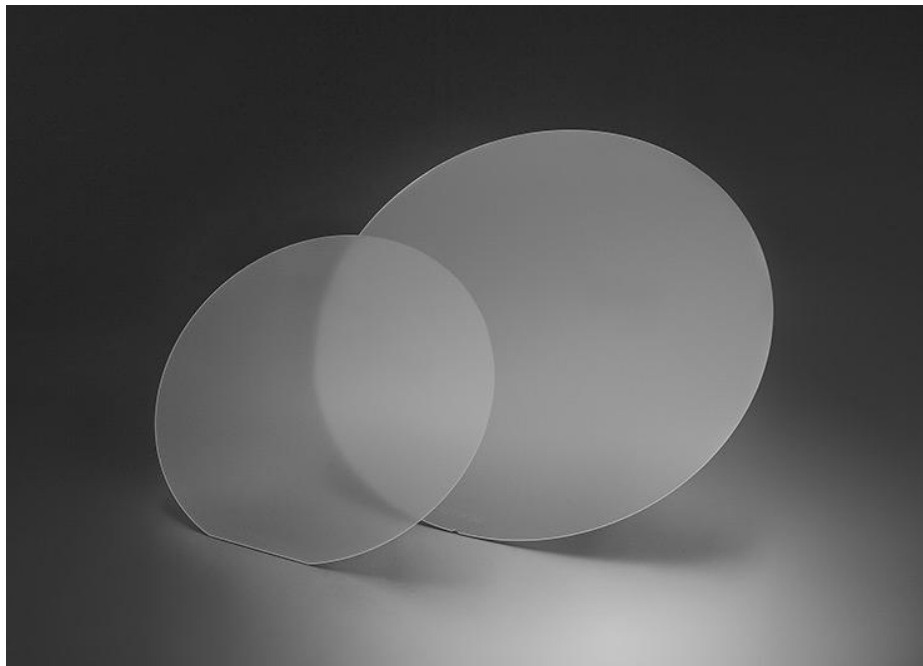
生成AIの急速な普及により、より高性能な半導体の需要が高まっています。「ハイセラムキャリア」は、複数の小型半導体チップを組み合わせることで高性能を実現するチップレット集積^{※1}において、半導体チップを一時的に固定するためのサポートウエハー(支持材)^{※2}です。そのため、ハイセラムキャリアは半導体製造のチップレット集積工程に欠かせない、重要な部材として注目されています。

ハイセラムキャリアには、当社が長年培ってきた透光性セラミックス「ハイセラム」^{※3}を採用しています。この素材は、光を通す性質に加え、高い剛性と耐久性を兼ね備えており、従来のガラス製サポートウエハーで課題となっていた製造時の反りや破損を大幅に低減します。これにより、お客様の製造工程の安定性が向上し、製品ロスの削減や品質向上に貢献します。

今回の設備投資では、製造を担う子会社「NGKセラミックデバイス株式会社(愛知県小牧市)」の生産設備を増強するとともに、前工程を担う「NGKエレクトロデバイス株式会社(山口県美祢市)」^{※4}にも新たに成形・焼成設備を導入します。これにより、グループ全体での生産能力を約3倍に拡大し、安定した供給体制を構築します。

NGKグループは、2050年を見据えた中長期ビジョン「NGKグループビジョン Road to 2050」において、カーボンニュートラル(CN)とデジタル社会(DS)分野への事業構成転換を掲げています。その通過点である2030年には、新事業で売上高1,000億円以上を目指す「New Value 1000」に取り組んでいます。ハイセラムキャリアは、次世代半導体の製造を支える重要な部材として、デジタル社会の発展に貢献していきます。

今後も当社は、独自のセラミック技術を活かし、カーボンニュートラルとデジタル社会分野における社会課題の解決に取り組んでいきます。



《ハイセラムキャリア》

- ※1 機能ごとに分割された複数の小型チップ（チップレット）を高密度に集積し、従来の単一チップと同等以上の性能を実現する技術。重要な機能のみを微細化することで、製造コストや歩留まりの最適化が可能。
- ※2 半導体製造工程でチップを一時的に固定するための基板。製造中の安定性を確保するために使用される。
- ※3 光を通す性質を持ちつつ、高い剛性と耐久性を兼ね備えたセラミック素材。高温・高負荷環境でも安定した性能を発揮する。
- ※4 26年4月1日（予定）に、NGKエレクトロデバイス株式会社の営業部門を会社分割の方法により日本ガイシ株式会社へ継承し、製造部門をNGKセラミックデバイス株式会社へ分割吸収合併を致します。

＜お問い合わせ先＞ コーポレートコミュニケーション部 / 狩谷、塚本 TEL: 052-872-7181